

2015年3月期 決算説明会

2015年5月12日

TOWA株式会社

東証1部:6315

本日の主な説明内容

1. 2015年3月期 業績結果
2. 2016年3月期 計画と取り組み
3. 中長期戦略と
「10年ビジョン」の進捗

本日の主な説明内容

1. 2015年3月期 業績結果
2. 2016年3月期 計画と取り組み
3. 中長期戦略と
「10年ビジョン」の進捗

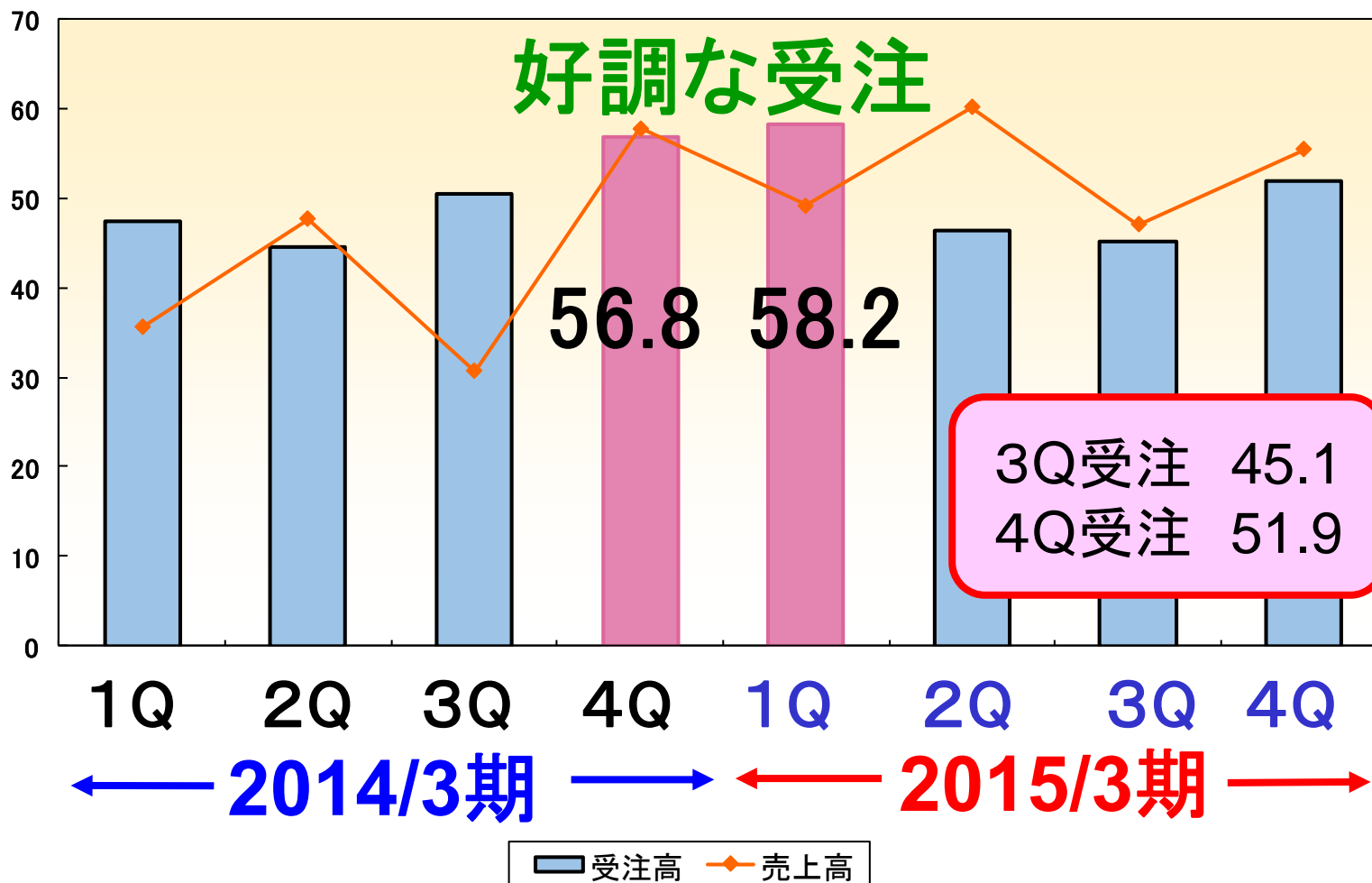
2015年 3月期 連結業績結果

(億円)

	2014/3	2015/3	前期比
売上高	171.7	212.0	1.2 倍
営業利益	4.6	16.7	3.7 倍
経常利益	6.7	23.2	3.5 倍
当期純利益	5.7	21.0	3.7 倍

受注高・売上高の推移

(億円)



2015年 3月期 連結業績結果

(億円)

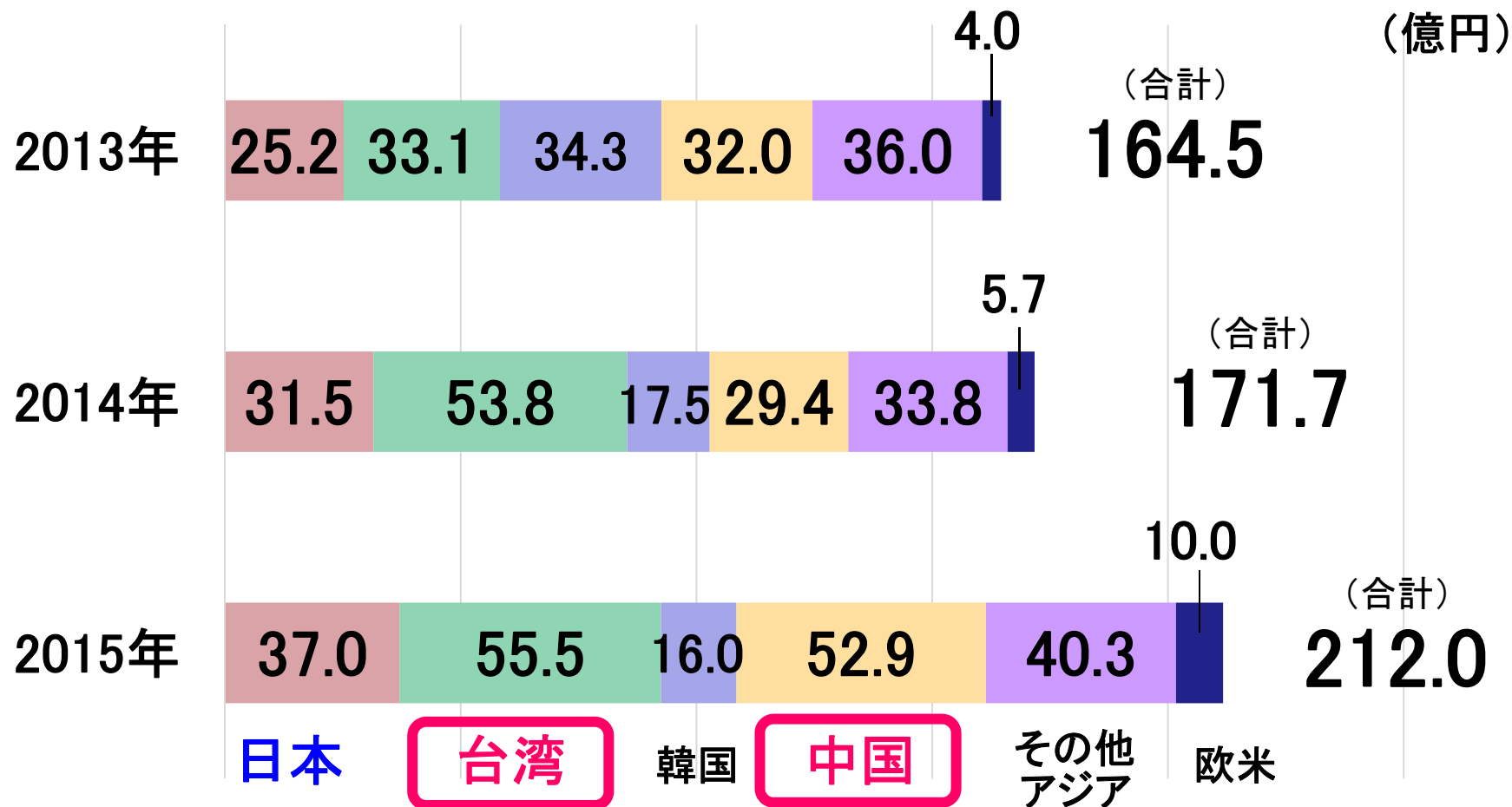
	期初計画	2014/11 上方修正	実績
売上高	180.0	210.0	212.0
営業利益	10.0	20.0	16.7
経常利益	9.0	23.0	23.2
当期純利益	8.0	18.0	21.0

2015年 3月期 セグメント別売上高

(億円)

	修正計画	実績
売上高	210.0	212.0
半導体製造用等精密金型	60.0	62.4
モールディング装置	113.2	110.6
LED樹脂封止装置・金型	14.8	14.3
シンギュレーション装置	8.0	11.3
ファインプラスチック成形品	12.0	12.1
新たな市場	2.0	1.4

地域別売上高推移



設備投資 ・ 配当

(単位：百万円)

	2013/3期	2014/3期	2015/3期
設備投資	1,262	1,482	1,301
配 当	10.0円	10.0円	10.0円
(連結配当性向)	(36.2%)	(44.0%)	(11.9%)

2015年 3月期 下期のトピック

2015年3月期 サマリー

●コンプレッションニーズが顕著

- ・コンプレッション比率**34%**に**上昇**
- ・ハイエンドPKGでは**コンプレッション不可欠**
- ・大手ファンドリーと**共同開発の促進**

●シンギュレーションの販路拡大

- ・**小型PKG**の切断技術確立
- ・中堅OSATからのロット受注→**他のOSATへ拡販**

2015年3月期 サマリー

● ファインプラスチック成形品事業への投資

- ・ 生産設備の**増強**
- ・ 医療機器メーカーより**開発を受託**
- ・ 投資額4億円(継続投資予定)
- ・ 生産能力**1.2倍**

● 新たな事業を着実に展開

- ・ ネプコンジャパン出展

異業種から引き合い増

ファインプラスチック成形品事業への投資



▲バンディック山梨事業所(全体)



増築部拡大



◀バンディック山梨事業所

ネプコン ジャパン 2015 出展

総称 **ネプコン ジャパン** (開催期間 2015/1/14~16)

第44回 **インターネプコン ジャパン**

エレクトロニクス製造・実装技術展



微細加工EXPO



カーエレクトロニクス展

展示内容

各種製品		微細加工 EXPO	カーエレクト ロニクス展
THPL-CBNエンドミル	高精度+再研削でトータルコストを半減、 超硬からCBNの時代へ	●	
超精密加工	超精密加工のあらゆるご要望と 部品受託加工に対応	●	●
バンセラコーティング	金型の離型性・防汚性を新次元に	●	
マイクロレンズアレイ	高精度マイクロレンズアレイが ヘッドアップディスプレイの高画質化を実現	●	●
EF品	微細形状の超精密金型を複製量産で 画期的にコストダウン	●	●
MEMS	シリコンに比べ低コスト!! 可動構造を持つポリマーMEMS	●	
コンプレッション モールド成形	高品質と樹脂歩留り100%で コストダウンを実現	●	●
ECUモジュール	エポキシ樹脂封止で小型化&信頼性向上		●

本日の主な説明内容

1. 2015年3月期 業績結果
- 2. 2016年3月期 計画と取り組み**
3. 中長期戦略と
「10年ビジョン」の進捗

2016年 3月期 連結業績計画

(億円)

	2015/3	2016/3	前期比
売上高	212.0	225.0	6.1 %
営業利益	16.7	23.5	40.6 %
経常利益	23.2	23.5	1.4 %
当期純利益	21.0	19.7	▲6.0 %

2016年 3月期 セグメント別売上高計画

	計 画	(億円)
売 上 高	225.0	
半導体製造用等精密金型	65.0	
モールディング装置	115.0	
LED樹脂封止装置・金型	15.0	
シンギュレーション装置	12.0	
ファインプラスチック成形品	13.0	
新たな市場	5.0	

設備投資 ・ 配当計画

(単位：百万円)

2016年3月期

設備投資

1,600

年間配当

10.0 円

2016年 3月期 主な取り組みと戦略

◆蘇州工場と九州事業所の増築

◆新規事業への積極的な投資

蘇州工場と九州事業所の増築

【2015年～3カ年計画】

- 総投資額 21億円
- 総床面積 1.5倍
- 生産能力 2.0倍



▲ 蘇州工場

TOWA10年ビジョンを見据えた投資

Equipment*からProduct***へ
変革加速**

新規事業への積極的な投資

研究開発への投資 前期比34%増



ガラス

新たなガラスニーズに応える

1. サファイアガラス
2. 薄板ガラス
3. ガラス端面強化

【用途】

- ・スマホカバー
- ・レンズカバー
- ・ナビゲーション／タブレットカバー
- ・ガラスインターポザー ・有機LED(OLED) など

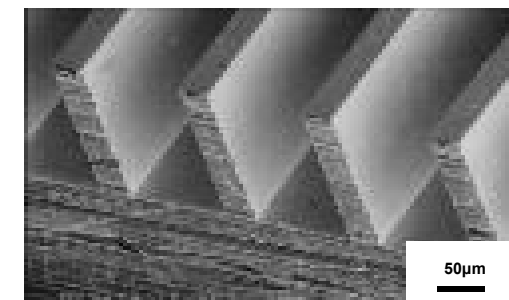
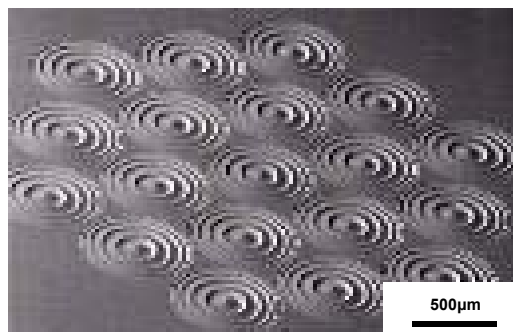
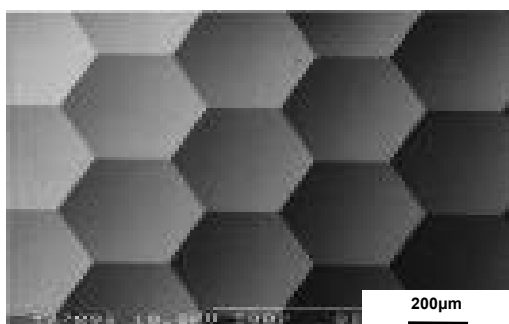
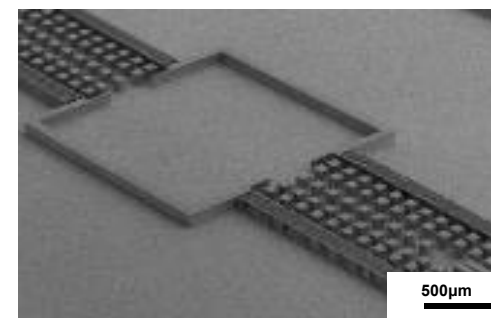
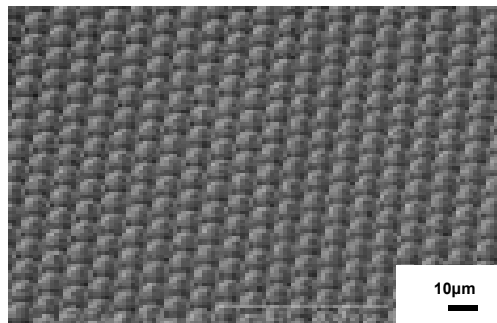


▲レーザーエンGRAービング装置

超精密・微細加工技術

超精密加工のあらゆるご要望と部品受託加工に対応

* ナノオーダーの加工面質 / サブミクロンオーダーの形状精度

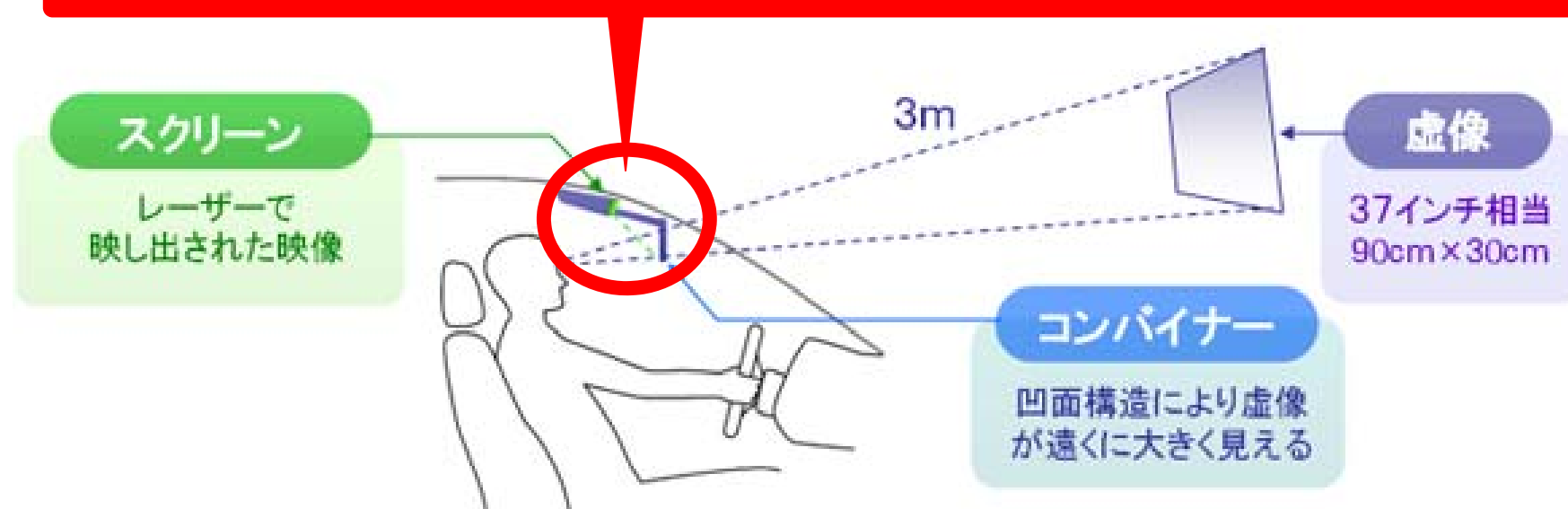
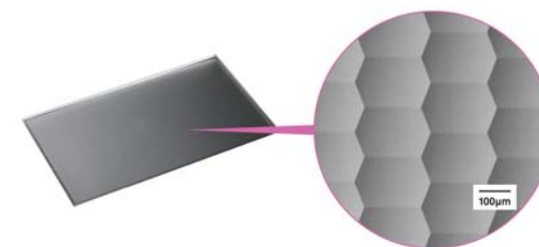


超精密・微細加工技術

《ヘッドアップディスプレイ》

当社独自技術による高精度マイクロレンズアレイが
ヘッドアップディスプレイの

高画質化を実現！



バンセラ

高表面硬度、高撥水性、高離型性 ⇒ 生産性向上、扱い易さ

1. 半導体樹脂封止

限定顧客(5社)に『BANCERA処理金型』納入し、
量産ベースでの臨床実験ステージ

2. 半導体以外での用途開発

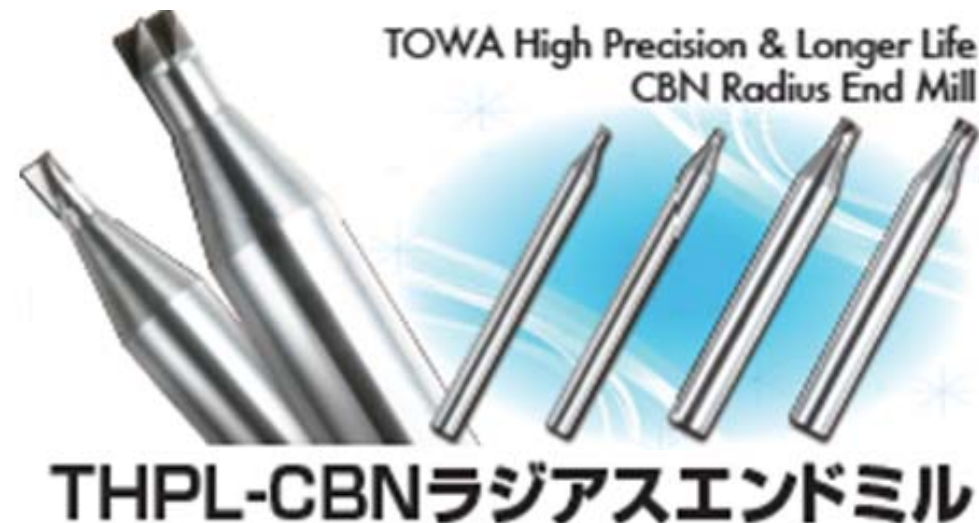
- ーガラス強化
- ー医療機器
- ー家庭製品
- ー防汚機能向上
- ー半導体以外の金型



CBN工具

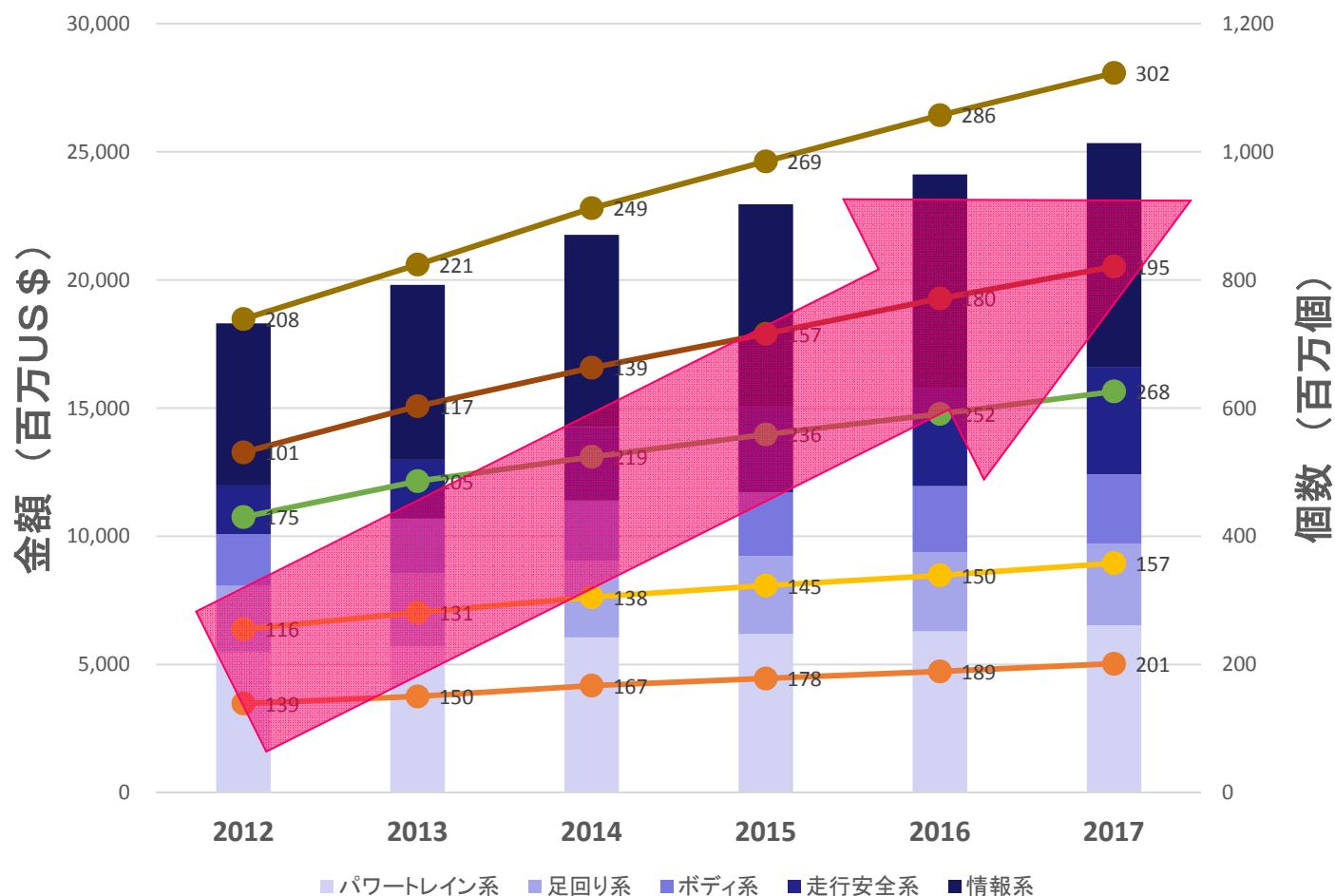
超硬からCBNへコスト半減

1. ダイヤモンドに次ぐ硬さ (当社比)
2. 高温下でも超硬以上の硬度
3. 耐摩耗性にすぐれ長寿命



車載関連

生産個数・金額ともに情報系ECUの伸びが期待できる。



本日の主な説明内容

1. 2015年3月期 業績結果
2. 2016年3月期 計画と取り組み
3. 中長期戦略と

「10年ビジョン」の進捗

「TOWA10年ビジョン」進捗状況

売上高250億円を実現するための事業の具現化

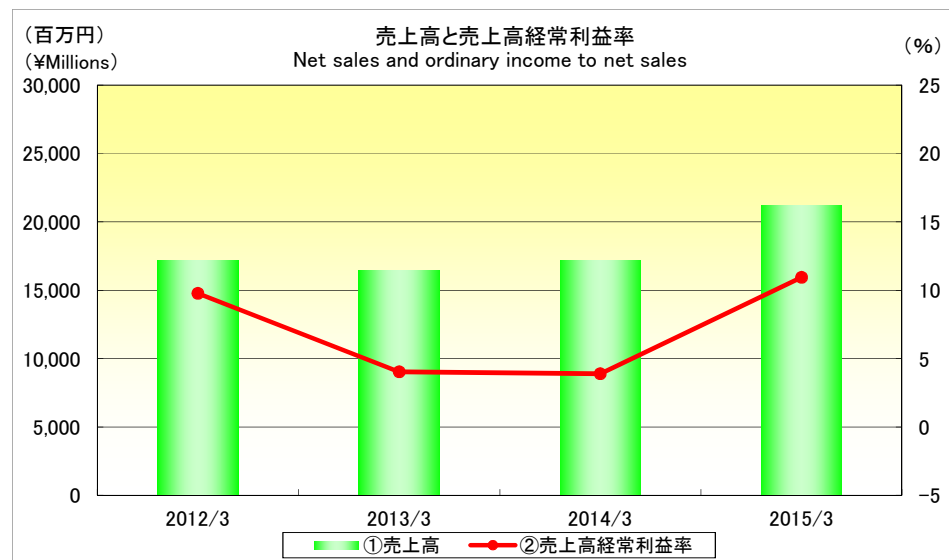
「新たな市場」事業の拡大

既存事業

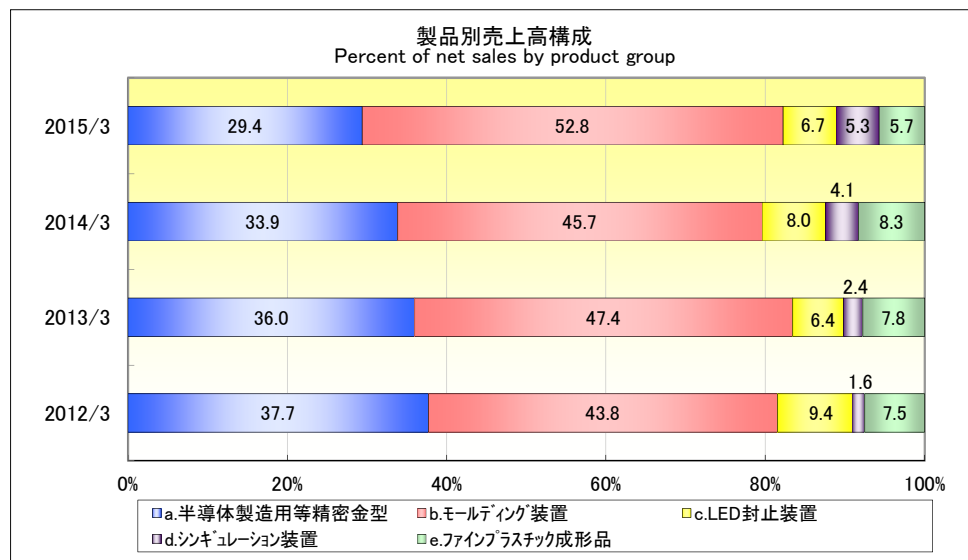


- ◆ 微細加工・受託
- ◆ ガラス事業・受託
- ◆ リリースフィルム
- ◆ 工具等消耗品
- ◆ TSS
- ◆ バンセラ 等

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



①Net sales ②Ordinary income to net sales

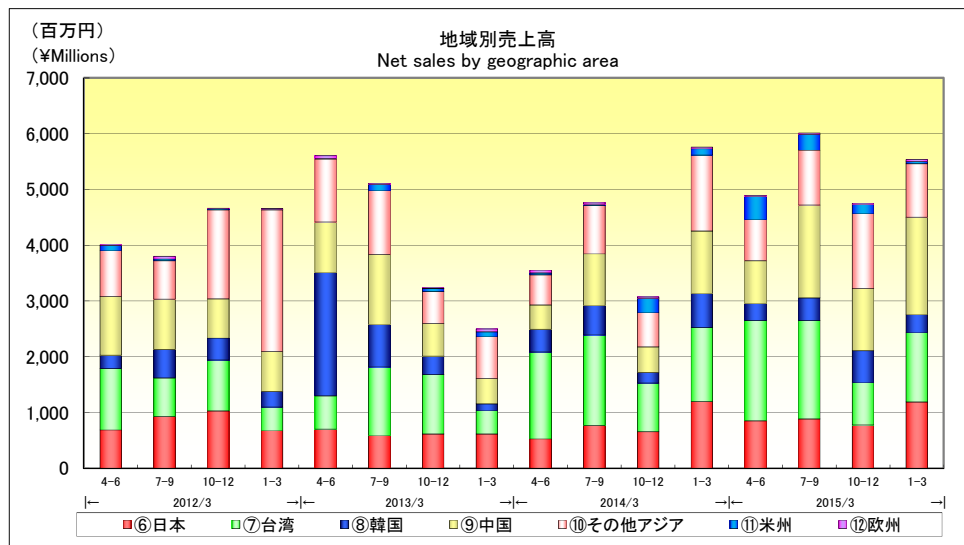
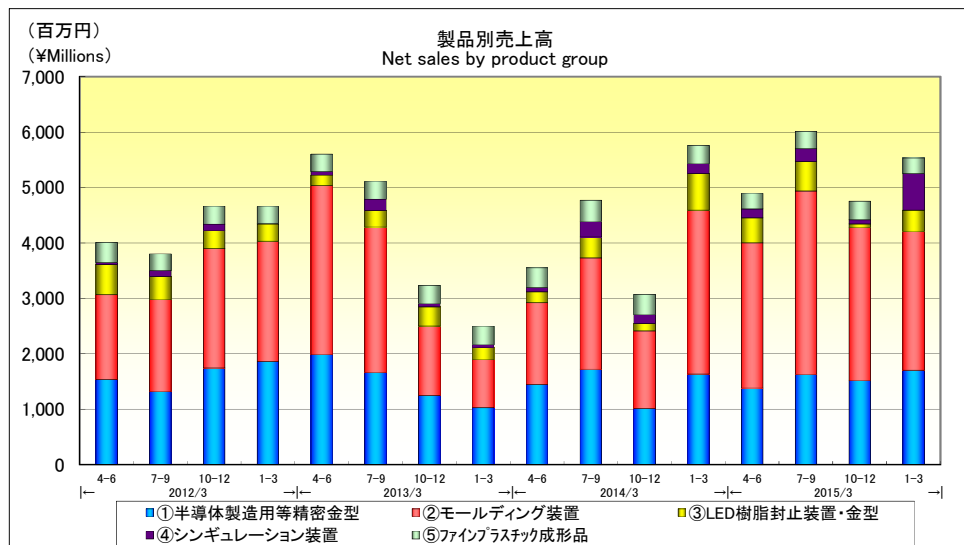


a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	Fiscal year	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2014/9
経営成績・財政状態 (百万円)	Operating results and financial conditions (¥Millions)					
売上高	Net sales	17,140	16,454	17,165	21,204	10,913
経常利益	Ordinary income	1,672	663	666	2,316	1,468
当期純利益	Net income	968	691	568	2,095	1,088
総資産	Total assets	26,817	25,896	29,132	31,735	31,650
純資産	Net assets	15,926	17,072	17,909	21,060	19,528
1株当たり指標(円)	Per share data(¥)					
1株当たり当期純利益	Net income per share	38.71	27.64	22.72	83.78	43.53
諸指標(%)	Data(%)					
自己資本当期純利益率	Return on equity	6.3	4.2	3.3	10.9	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	6.2	2.5	2.4	7.6	-
売上高経常利益率	Ordinary income to net sales	9.8	4.0	3.9	10.9	13.5
自己資本比率	Equity ratio	59.4	65.2	60.6	65.4	60.7

(単位:百万円/¥Millions)

Ⅱ. 四半期売上高動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



製品別売上高 Net sales by product group

(単位:百万円/¥Millions)

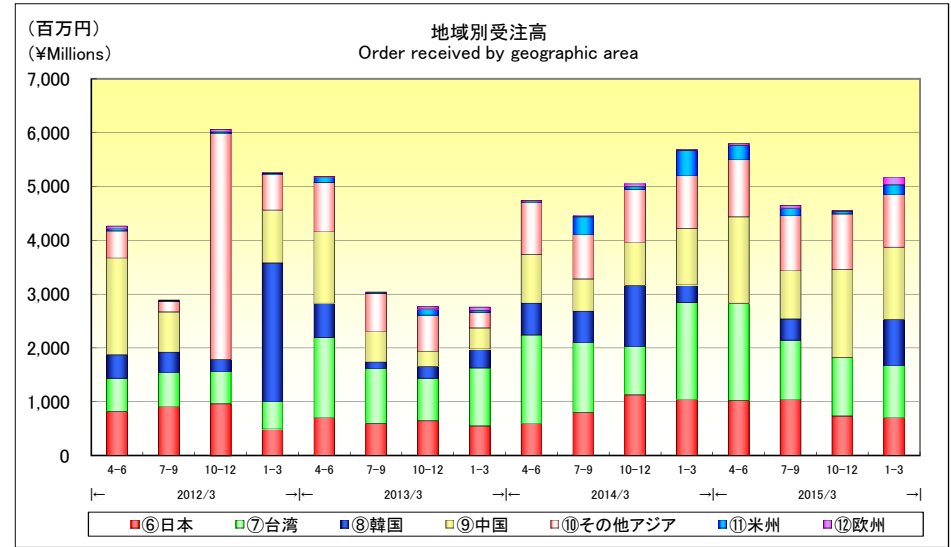
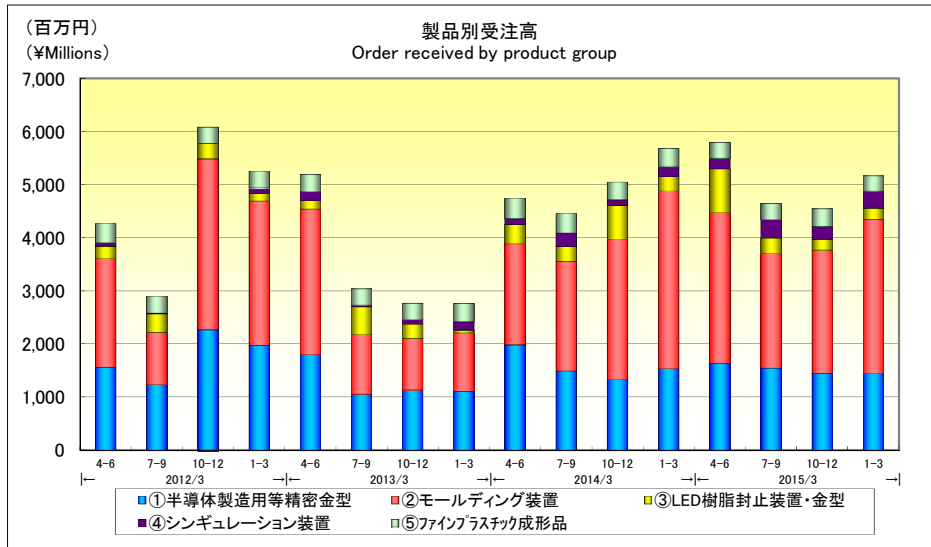
決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	6,016	4,755	5,535	21,204
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	1,026	5,923	1,443	1,723	1,009	1,634	5,810	1,382	1,632	1,515	1,705	6,236
モールドング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	870	7,801	1,479	2,007	1,406	2,958	7,852	2,620	3,305	2,767	2,507	11,201
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	544	418	333	312	1,608	187	299	347	220	1,055	197	378	133	657	1,367	451	532	62	378	1,425
シングレーション装置 ④Singulation parts and systems	38	104	111	12	267	67	204	65	57	395	82	285	158	182	710	163	233	75	658	1,131
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	359	303	323	301	1,287	311	318	322	325	1,277	351	377	367	327	1,424	279	311	333	285	1,210
月平均	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	834	1,371	1,185	1,591	1,025	1,920	1,430	1,632	2,005	1,585	1,845	1,767

地域別売上高 Net sales by geographic area

(単位:百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	6,016	4,755	5,535	21,204
日本 ⑥Japan	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	614	2,521	527	772	654	1,195	3,150	849	884	776	1,190	3,701
台湾 ⑦Taiwan	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	423	3,314	1,556	1,619	873	1,326	5,376	1,800	1,763	767	1,243	5,576
韓国 ⑧Korea	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	119	3,428	408	528	189	618	1,745	305	409	564	320	1,599
中国 ⑨China	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	453	3,189	436	926	462	1,116	2,941	767	1,662	1,113	1,747	5,290
その他アジア ⑩Other asia	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	748	3,604	543	870	609	1,361	3,384	743	987	1,348	959	4,039
米州 ⑪America	94	32	25	11	164	14	112	53	89	269	31	20	263	112	428	418	284	166	41	911
欧州 ⑫Europe	10	47	4	11	74	44	16	12	52	126	51	34	23	29	137	12	23	17	33	85

Ⅲ. 四半期受注高動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



製品別受注高 Order received by product group

(単位:百万円/¥Millions)

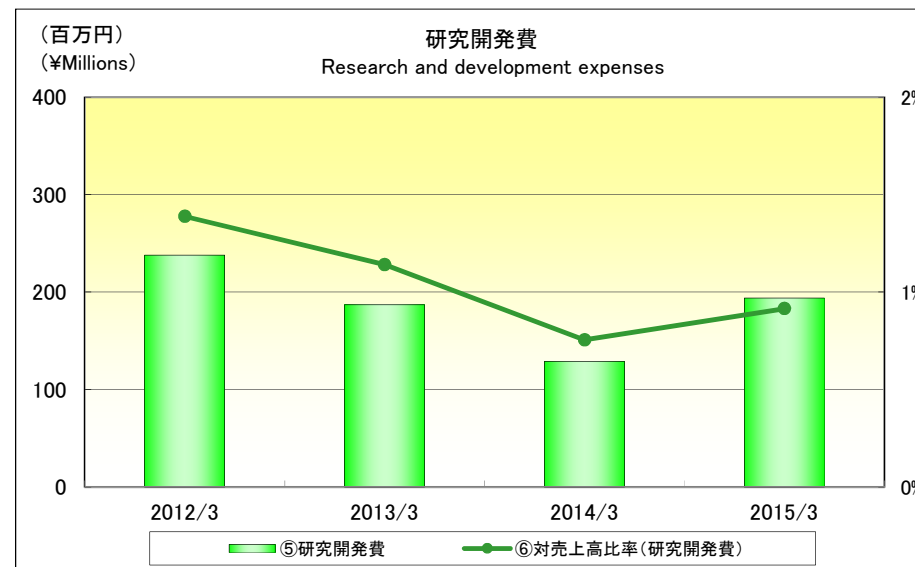
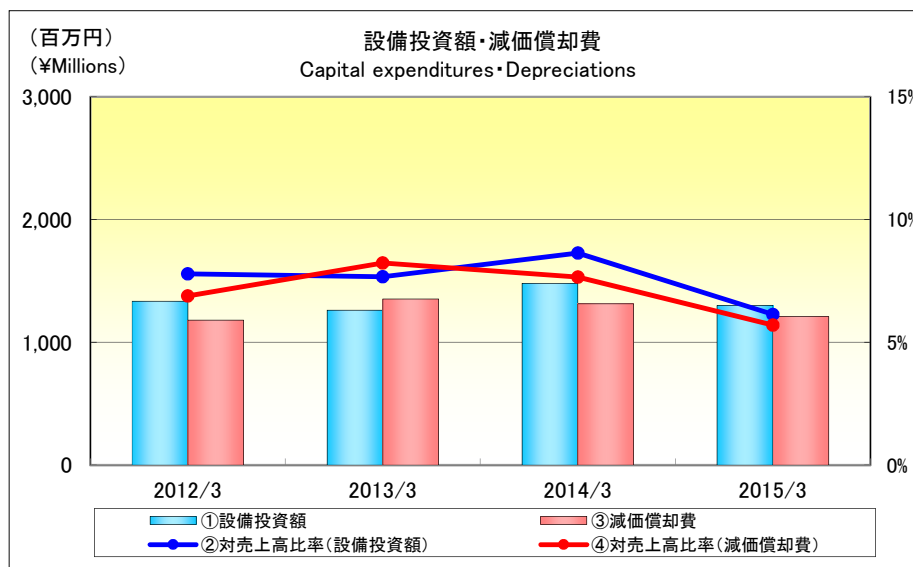
決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,793	4,648	4,548	5,168	20,158
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	1,101	5,083	1,980	1,490	1,326	1,539	6,336	1,633	1,545	1,444	1,447	6,070
モールドング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	1,103	5,934	1,904	2,067	2,643	3,339	9,954	2,841	2,158	2,322	2,900	10,223
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	227	348	289	147	1,013	168	529	270	53	1,021	365	275	642	273	1,556	820	289	204	210	1,524
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	73	16	-29	103	164	160	30	90	158	439	107	257	101	198	664	203	351	243	318	1,117
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	350	307	309	313	1,281	322	306	304	346	1,279	383	362	335	327	1,409	294	303	333	292	1,223
月平均	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	921	1,147	1,580	1,485	1,683	1,892	1,660	1,931	1,549	1,516	1,723	1,680

地域別受注高 Order received by geographic area

(単位:百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,793	4,648	4,548	5,168	20,158
日本 ⑥Japan	821	906	963	495	3,187	703	593	645	551	2,494	602	802	1,130	1,048	3,583	1,023	1,036	789	709	3,559
台湾 ⑦Taiwan	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	1,079	4,392	1,639	1,299	894	1,793	5,626	1,805	1,110	1,156	964	5,036
韓国 ⑧Korea	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	352	1,328	592	583	1,139	330	2,645	1	392	-316	853	932
中国 ⑨China	1,801	746	-8	981	3,520	1,327	564	284	389	2,566	902	598	794	1,046	3,341	1,608	895	1,749	1,346	5,599
その他アジア ⑩Other asia	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	293	2,579	966	823	990	989	3,770	1,060	1,030	1,109	982	4,182
米州 ⑪America	44	19	27	25	117	99	16	112	34	263	17	330	49	467	864	266	132	43	175	617
欧州 ⑫Europe	43	4	46	9	104	16	13	42	62	134	20	16	50	2	89	27	49	17	136	230

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)	(Consolidated)	(単位: 百万円/¥Millions)			
決算期	Fiscal year	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3
キャッシュフロー	Cash flows				
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	1,897	2,710	935	2,612
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-112	-1,083	-1,553	-1,452
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-2,280	-817	819	-1,173
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	4,395	5,266	5,533	5,617
設備投資額	①Capital expenditures	1,336	1,262	1,482	1,301
対売上高比率(%)	②Ratio of sales (%)	7.79	7.67	8.64	6.14
減価償却費	③Depreciations	1,181	1,354	1,314	1,209
対売上高比率(%)	④Ratio of sales (%)	6.89	8.23	7.66	5.71
研究開発費	⑤Research and development expenses	238	187	129	194
対売上高比率(%)	⑥Ratio of sales (%)	1.39	1.14	0.75	0.92

この資料に関するお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。